

SU-8 마스크를 이용한 유리의 입자분사 미세가공 정밀도 평가

A. S. Saragih (영남대 대학원), 고태조*, 김희술(영남대), 박영우(충남대), 이인환(충북대)

Precision assessment of micro abrasive jet machining result on glass by using thick SU-8 as a mask

A. S. Saragih (YU), T. J. Ko*, H. S. Kim (YU), Y. W. Park(CNU), I. H. Lee(CBNU)

ABSTRACT

SU-8 can be implemented as a mask for micro Abrasive Jet Machining (micro-AJM) process [1]. In this paper, we will evaluate the quality of micro grooving result on glass substrate by micro-AJM process which using SU-8 as a mask. It was evaluated on width and edge profile of the micro grooving. The result was having distortion compare with the master film used to pattern the SU-8 mask. The value of distortion with other properties which came along with it, such as depth and surface roughness, can be optimized in order to fabricate micro-channel for micro-fluidic application.

Key Words: micro grooving (미세 흙 가공), micro-AJM (미세 입자분사가공), SU-8 mask (SU-8 마스크)

1. 서론

미세 입자분사가공은 Fig. 1 과 같이 가압된 기체를 이용하여 미세입자를 고속으로 분사하고, 그 충격 에너지를 이용하여 가공하는 방법이다. 따라서 건식 에칭용으로 이용을 하게 되면 높은 에칭률을 얻을 수 있으며, 클린룸과 같은 특별한 설비를 필요하지 않은 장점이 있다.

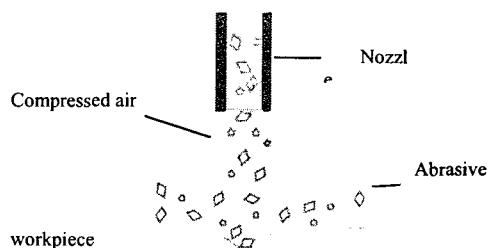


Fig. 1 Schematic diagram of the micro-AJM

미세가공을 위해서는 패턴 마스크 상에서 가공을 수행해야 하며, 패턴 마스크로서는 경제성과 해상도 측면에서 광 경화성 재료를 일반적으로 이용한다. 그 중에서 SU-8은 미세입자가공용 마스크 재료로서 적당한데, 그 이유는 높은 cross link로 패턴 두께를 두껍게 할 수 있으며, 복잡한 미세패턴을 만들 수 있다. 따라서 고세장비를 구현할 수 있으며, 수직격벽을 얻을 수 있기 때문에 미세입자가공에서 입자침식에 대한 저항성이 크다. 본 논문에서는 상기와 같은 장점을 지닌 SU-8을 패턴 마스크로 사용할 시에 입자분사가공에서 발생하는 정밀도

를 평가하는 것이 목적이다.

2. 실험방법

실험에 사용한 광경화성 재료는 MicroChem 사의 SU-8 2100이다. 가공용 재료는 Soda lime 유리기판으로 Knoop 경도는 $585 \text{ kg/mm}^2 \pm 20$ 이며, 두께는 1mm이다. 유리기판은 hot Piranha($75\% \text{ H}_2\text{SO}_4 : 25\% \text{ H}_2\text{O}_2$)에서 세정 후, 접착력을 증가시키기 위해 200°C 오븐에서 10분간 건조를 하였다. 그 이후, 마스크를 제작하는 공정을 수행하였는데, 두께 250, 300, 350 μm , 패턴의 측 200 μm 의 패턴 마스크를 만들었다.

Table 1 Process parameters for micro-AJM process

Parameters	Value
Nozzle size (rectangle size)	0.18x3.75mm
Stand-off distance	20 mm
Air pressure	300 kPa
Flow rate	5 gr/min
Scanning speed	0.5 mm/s

마스트가 입혀진 유리기판위에 입자분사가공을 실시하게 되는데, 입자분사가공기는 Crystal 사의 SwamBlast를 사용하였다. 입자분사가공에서 사용한 입자의 크기는 17.5 μm 이며, 각종 공정조건은 Table 1과 같다.

가공완료 후 남아있는 SU-8은 Piranha 용액에서 제거가 되었으며, 초음파 세척기를 이용하였다. 최종적으로 acetone, methanol, 그리고 DI 수 순으로 세척을 하였다. Fig. 2는 전체적인 과정을 보이는 사진이다.

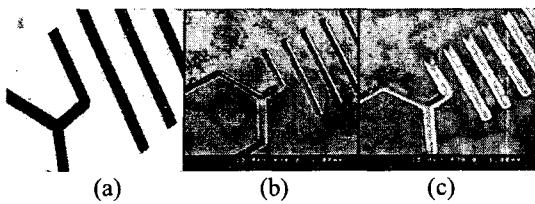


Fig. 2 (a) mask film-200 μm width, (b) masked pattern, (c) machined glass

AJM 가공 후에 접촉식 및 비접촉식 프로파일러를 사용하였 변형을 측정하였다. 또한 SEM 과 광학 현미경을 이용하여 형상을 조사하였다. Fig. 3은 변형을 측정하기 위한 방법을 나타낸 그림이다.

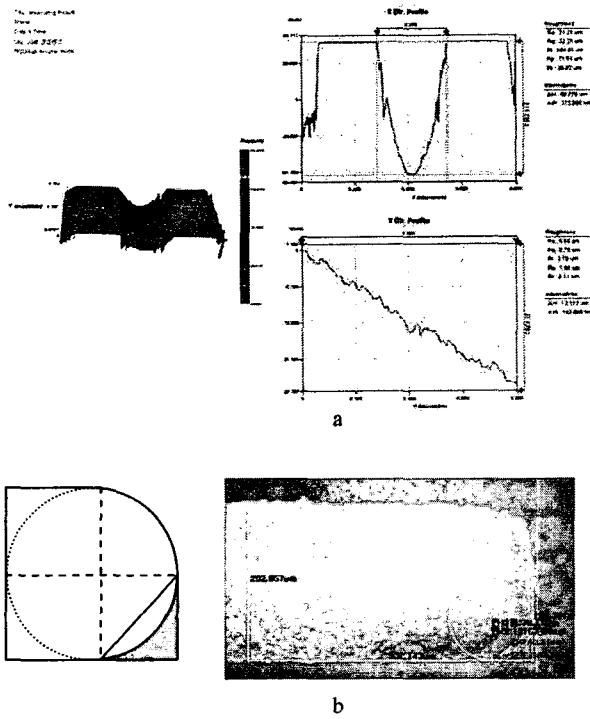


Fig. 3. Method to calculate distortion (a) width distortion, (b) edge distortion

3. 실험결과

Fig. 4, 5는 각각 폭 변형 및 상면 모서리부의 변형결과이다. 마스크의 두께에 따라서 모서리 변형이 뚜렷하고, 입자분사시간, 즉 가공 시간에 따라서 폭변형이 크게 영향을 받는 것을 관찰할 수 있다. 한편, 마이크로 채널에서 깊이를 크게 할 경우는 가공시간을 늘이면 가능하지만 상대적으로 폭변형이 많이 발생한다. 또한 얇은 마스크가 모서리 변형을 작게 하지만, 깊은 구멍을 가공할 수는 없다.

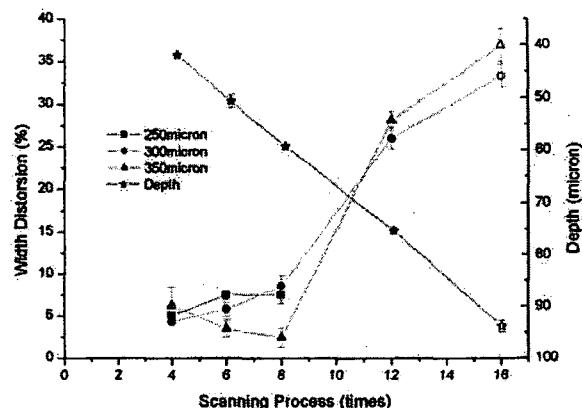


Fig. 4 Graph of width distortion based on mask thickness, combine with depth of micro grooving result against scanning times

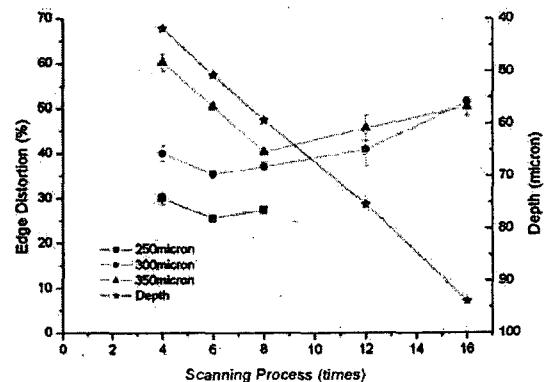


Fig. 5 Graph of edge distortion based on mask thickness, combine with depth of micro grooving result against scanning times

4. 결론

AJM 가공으로 마이크로 채널 등 미세 홈을 에칭가공할 시에는 선폭의 형성과 상면 모서리부의 라운드 형성 경향을 측정하였다. 이를 바탕으로 최적의 에칭 깊이를 선정하는 것이 가능하다.

후기

본 연구는 한국 과학 재단 목적 기초 연구(R01-2004-000-10556-0) 지원으로 수행되었습니다.

참고문헌

- Zang J., Tan K. L. and Gong H. Q., 2001 Characterization of the polymerization of SU-8 photoresist and its application in MEMS polimer teseting 20 (201) 693-701